

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 4 年 3 月 29 日(2022.3.29)

【公開番号】特開 2021-27279(P2021-27279A)

【公開日】令和 3 年 2 月 22 日(2021.2.22)

【年通号数】公開・登録公報 2021-009

【出願番号】特願 2019-146311(P2019-146311)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46(2006.01)

H 0 5 K 3/00(2006.01)

H 0 1 L 23/12(2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/46 Q

H 0 5 K 3/00 X

H 0 1 L 23/12 5 0 1 P

H 0 1 L 23/12 B

10

【手続補正書】

【提出日】令和 4 年 3 月 17 日(2022.3.17)

20

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 7 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 7 7】

積層構造 2 0 0 は、良品エリア 1 4 1 及び不良品エリア 1 4 2 を備え配線層 1 7 0 を含む配線構造 1 8 0 と、配線構造 1 8 0 の上面に形成された絶縁層 7 0 とを有する。良品エリア 1 4 1 において、絶縁層 7 0 を厚さ方向に貫通する開口部 1 0 0 が形成され、不良品エリア 1 4 2 において、絶縁層 7 0 を厚さ方向に貫通する環状の溝 1 5 0 が形成されている。積層構造 2 0 0 は、更に、良品エリア 1 4 1 において、開口部 1 0 0 内に、開口部 1 0 0 の壁面 1 0 0 A との間に環状の隙間をあけて搭載された電子部品 1 1 0 と、不良品エリア 1 4 2 において、溝 1 5 0 の内側に位置する絶縁部材 7 0 Z と、この隙間及び溝 1 5 0 を充填し、絶縁層 7 0 と電子部品 1 1 0 と絶縁部材 7 0 Z とを被覆する絶縁層 8 0 と、絶縁層 8 0 の上面に形成され、配線層 1 7 0 に電氣的に接続された配線層 9 0 と、を有する。

30

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1

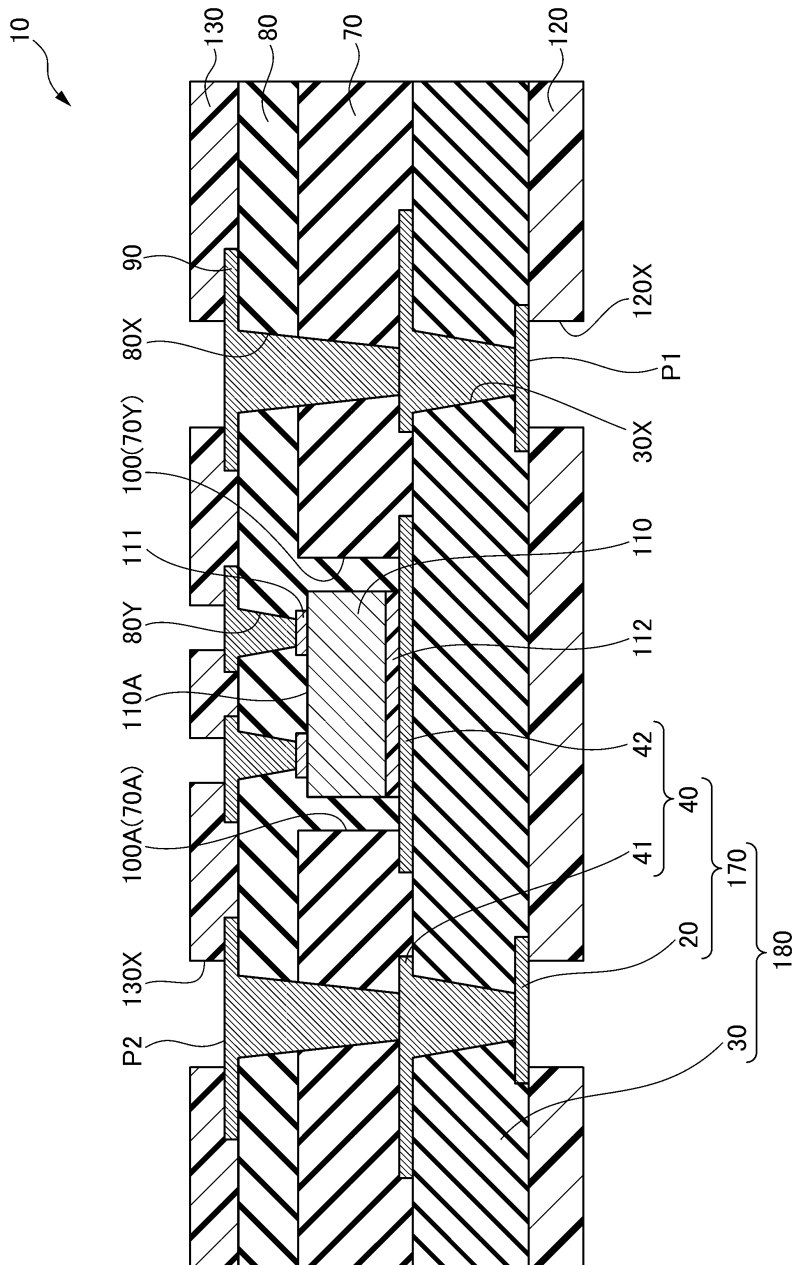
【補正方法】変更

【補正の内容】

40

## 【図 1】

実施形態により製造する配線基板の構造を示す断面図



【手続補正 3】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

10

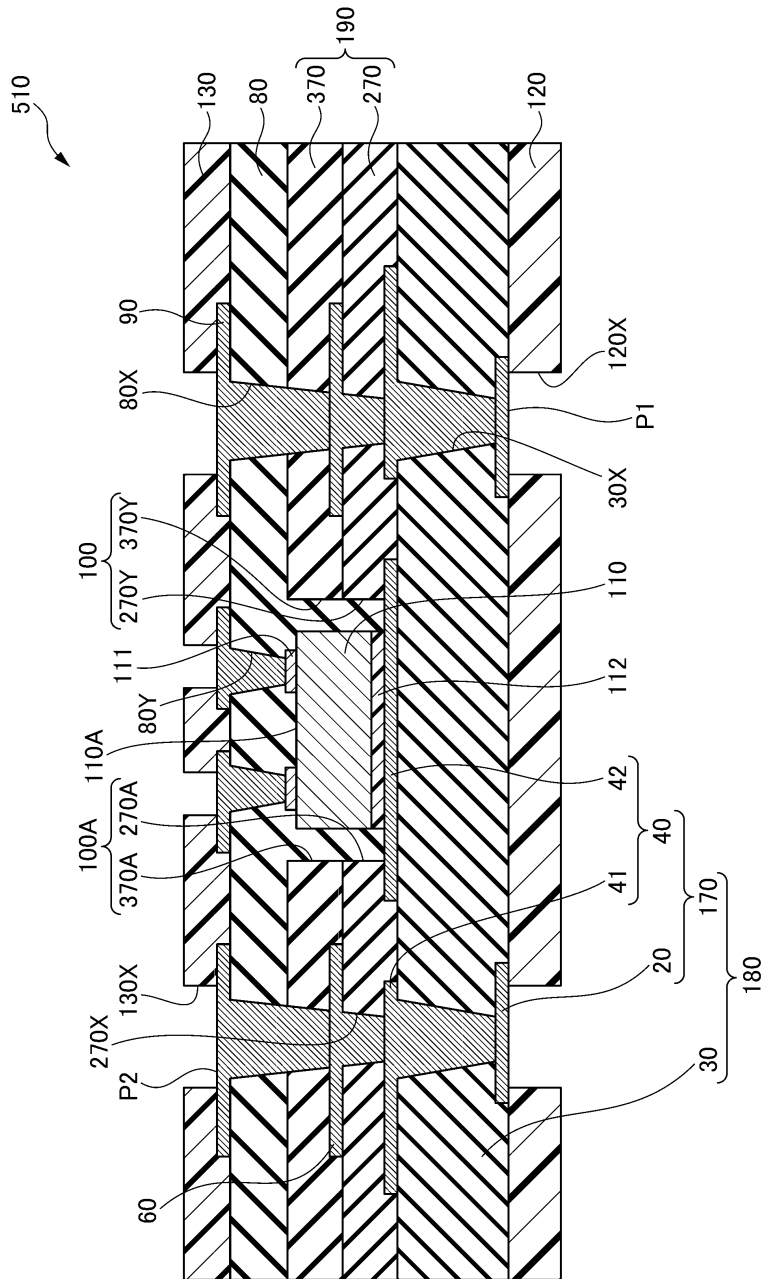
20

30

40

50

実施形態の変形例により製造する配線基板の構造を示す断面図



10

20

30

40